

IEEE EMCS Japan Joint / Sendai Chapter 講演会

IEEE EMC Society Japan Joint/Sendai Chapters では、会員サービスの一環と致しまして、IEEE EMCS Award 等受賞者、EMC Japan/APEMC Okinawa General Chair、IEEE EMCS BOD Member、IEEE EMCS Japan Joint Chapter/Sendai Chapter Chairs による講演会を開催致します。本講演会は事前に参加申し込みをして頂くことで IEEE 会員/非会員に関わらず、どなたでも自由に参加頂けます。IEEE 非会員のみなさまにはこの機会に IEEE の活動を知っていただく機会にさせていただければと存じます。多くの方のご参加をお待ちしています。

主 催： **IEEE EMCS Japan Joint / Sendai Chapters**

期 日： **2025 年 1 月 21 日 火曜日 13:00～17:00**

会 場： 機械振興会館地下 3 階研修 1 号室【ハイブリッド開催】

オンラインアクセスのための WebEx の URL は登録いただいた方に申し込み締め切り後にお知らせいたします。(12:30 会場オープン)

参加申込み： 本講演会は事前参加申し込みとしています。期日までに下記 URL からお申し込みください。

申し込み先： <https://forms.office.com/r/RAXjUkz919>

申込締め切り： **1 月 10 日(金) 17 時**

<プログラム> (敬称略)

13:00～13:05 開会挨拶

講演

13:05～14:10 【招待講演】

「ウェアラブルデバイス及び車載イーサネット用 IC に対する静電気放電試験の課題検討」

王 建青 (名古屋工業大学; 2023-2024 IEEE EMCS Distinguished Lecturer)

14:10～14:50 【記念講演 1】 Richard B. Schulz Best Paper Award

「Echo TEMPEST: EM Information Leakage Induced by IEMI for Electronic Devices」

林 優一・鍛冶 秀伍・藤本 大介 (奈良先端科学技術大学院大学)・

衣川 昌宏 (福知山公立大学)

14:50～15:30 【記念講演 2】 IEEE EMC+SIPI 2024 Best SIPI Symposium Paper Award

「Reducing EMI in Wire-Bond BGA IC-Chips through Magnetic Dipole Moment Control」

多湖 敏司・佐々木 慶太・落合 保博 (ソニーセミコンダクタソリューションズ)

15:30～15:40 休憩

15:40～15:50 受賞紹介

Technical Achievement Award (NICT 渡辺様)

Distinguished Reviewers (電中研 立松様、名工大 小寺先生)

15:50～16:05 「EMC Japan/APEMC Okinawa 報告」

豊田 啓孝 (EMC Japan/APEMC Okinawa General Chair、岡山大学)

16:05～16:20 「IEEE EMCS BoD 報告」

福本 幸弘 (IEEE EMCS BoD、九州工業大学)

16:20～16:35 「IEEE EMCS Sendai Chapter 活動報告」

佐藤 健 (Sendai Chapter Chair、小山工業高等専門学校)

16:35～16:50 「IEEE EMC Society Japan Joint Chapter 活動報告」

渡辺 聡一 (IEEE EMCS Japan Joint Chapter Chair, NICT)

16:50～16:55 閉会挨拶

【HP】

EMCS JJC <https://www.ieee-jp.org/section/tokyo/chapter/EMC-27/>

EMCS Sendai <https://www.topic.ad.jp/emc-sendai/>

■参加申込みに関するお問い合わせ

Secretary, IEEE EMC Society Japan Joint Chapter

長尾 篤

NTT 宇宙環境エネルギー研究所

TEL :0422-59-3814

E-mail: atsushi.nagao@ntt.com